****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader Enquiries:** | **Press Contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com[www.congatec.es](http://www.congatec.es)  | info@sams-network.com[www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Texto y foto también disponible online en: https://www.congatec.com/es/congatec-ag/notas-de-prensa.html*

**Presentación de Nuevo producto**

Módulos congatec COM Express con los nuevos procesadores Intel® Xeon® e Intel® Core ™ de 8ª generación (Coffee Lake H)

**Potente módulo de seis núcleos para Type 6**

**Deggendorf, Alemania, 3 de abril de 2018** **\* \* \*** congatec, un proveedor líder de placas y módulos informáticos embebidos estándar o personalizados, presenta su nuevo modelo de módulo COM (Computer-on-Module) conga-TS370 COM Express Type 6, en paralelo con el lanzamiento de la 8ª generación de procesadores Intel® Xeon® e Intel® Core™ Embedded (nombre en código Coffee Lake H). Impulsan la clase TDP 35-45 W de los módulos COM Express Type 6 a un nuevo nivel "six-pack" de sistemas embebidos de alta gama, que ofrece por primera vez hasta 6 núcleos, 12 hilos y un impresionante turbo boost de hasta a 4.4 GHz que gestiona hasta tres pantallas UHD independientes de 4k. Las pruebas iniciales de Congatec indican que estos nuevos módulos de seis núcleos pueden realizar hasta entre un 45 y un 50 por ciento más de múltiples subprocesos, y presentan entre un 15 y un 25 por ciento más de rendimiento de un solo subproceso, en comparación con las variantes basadas en el procesador de 7ª generación Intel® Core™. En una TPD determinada, los diseños del sistema logran un mayor ancho de banda con un consumo total de energía menor, lo que en última instancia conduce a una mayor eficiencia del sistema. Las aplicaciones de destino, para estos módulos, son sistemas embebidos y móviles de alto rendimiento, estaciones de trabajo industriales y médicas, servidores de almacenamiento y estaciones de trabajo en la Nube, así como transcodificación de medios y núcleos de cálculo.

"En los mercados de imágenes médicas e Industria 4.0, así como análisis de video para, por ejemplo, el conocimiento de la situación y la observación del transporte, están interesados ​​en cualquier mejora en el rendimiento", explica Martin Danzer, Director de Gestión de Producto de congatec. "Simplificamos el uso de estas mejoras de rendimiento con nuestros módulos COM, soluciones de refrigeración y eAPI estandarizados, haciendo que la actualización a las últimas generaciones de procesadores sea más o menos una tarea plug & play".

Además de los aumentos de rendimiento, los nuevos módulos de congatec impresionan por la disponibilidad ampliada a largo plazo de 10 años más, las E / S de gran ancho de banda con 4x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit / s) y soporte de memoria Intel® Optane™, así como seguridad mejorada características que incluyen las extensiones Intel® Software Guard, Trusted Execution Engine y Intel® Platform Trust Technology.

**El conjunto de características al detalle**

Los nuevos módulos COM conga-TS370 COM Express Basic Type 6 están disponibles con procesadores Intel® Xeon® e Intel® Core ™ i7 de seis núcleos, o procesadores Intel® Core ™ i5 de cuatro núcleos en un envolvente cTDP de 35 a 45 W y hasta 32 GB de memoria DDR4 2666 con opción ECC. Los gráficos integrados Intel® UHD630 admiten hasta tres pantallas 4k independientes con hasta 60Hz a través de DP 1.4, HDMI, eDP y LVDS. Por primera vez, los diseñadores pueden cambiar ahora de eDP a LVDS puramente por software sin ningún cambio hardware. Los módulos destacan por sus E / S de gran ancho de banda, incluyendo 4x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit / s), 8x USB 2.0 y 1x PEG y 8 líneas PCIe Gen 3.0 para extensiones de sistema potentes, incluida la memoria Intel® Optane™. Todos los sistemas operativos Linux comunes, así como las versiones de 64 bits de Microsoft Windows 10 y Windows 10 IoT son ejecutables. Un soporte de integración personal de clase Premium, en combinación con una amplia gama de accesorios, así como placas y sistemas de soporte estandarizados, o customizados, completan el paquete de servicios de los nuevos módulos.

Los nuevos módulos COM conga-TS370 COM Express Type 6 se pueden pedir en las siguientes configuraciones estándar:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesador** |  | **Núcleos/Threads** |  | **Clock [GHz] (Base/Boost)** |  | **Cache (MB)**  |  | **TDP / cTDP [W]**  |
| Intel® Xeon® E-2176M |  | 6 / 12 |  | 2.7 / 4.4 |  | 12 |  | 45 / 35 |
| Intel® Core™ i7-8850H |  | 6 / 12 |  | 2.6 / 4.3 |  | 9 |  | 45 / 35 |
| Intel® Core™ i5-8400H |  | 4 / 8 |  | 2.5 / 4.2 |  | 8 |  | 45 / 35 |

Se puede obtener más información acerca del nuevo módulo COM Express Type 6 de alto rendimiento conga-TS370 en: <https://www.congatec.com/es/productos/com-express-type6/conga-ts370.html>

**Sobre congatec**congatec es un proveedor líder de módulos informáticos industriales que utilizan los factores de forma estándar COM Express, Qseven y SMARC, así como ordenadores monoplaca y servicios de personalización. Los productos de congatec se pueden utilizar en varias industrias y aplicaciones, tales como la automatización industrial, médicina, entretenimiento, transporte, telecomunicaciones, prueba y medida, y punto de venta. El conocimiento básico y los conocimientos técnicos incluyen características exclusivas del BIOS ampliado, así como paquetes integrales de soporte para el controlador y la placa. Después de la fase de diseño, los clientes reciben asistencia a través de una amplia gestión del ciclo de vida del producto. Los productos de la compañía son fabricados por proveedores de servicios especializados de acuerdo con los modernos estándares de calidad. Congatec, con sede en Deggendorf, Alemania, actualmente tiene delegaciones en EE. UU., Taiwán, China, Japón y Australia, así como en el Reino Unido, Francia y la República Checa. Más información está disponible en nuestro sitio web en [www.congatec.com](http://www.congatec.com) o via [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) y [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel and Core, Xeon, and Optane are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*